

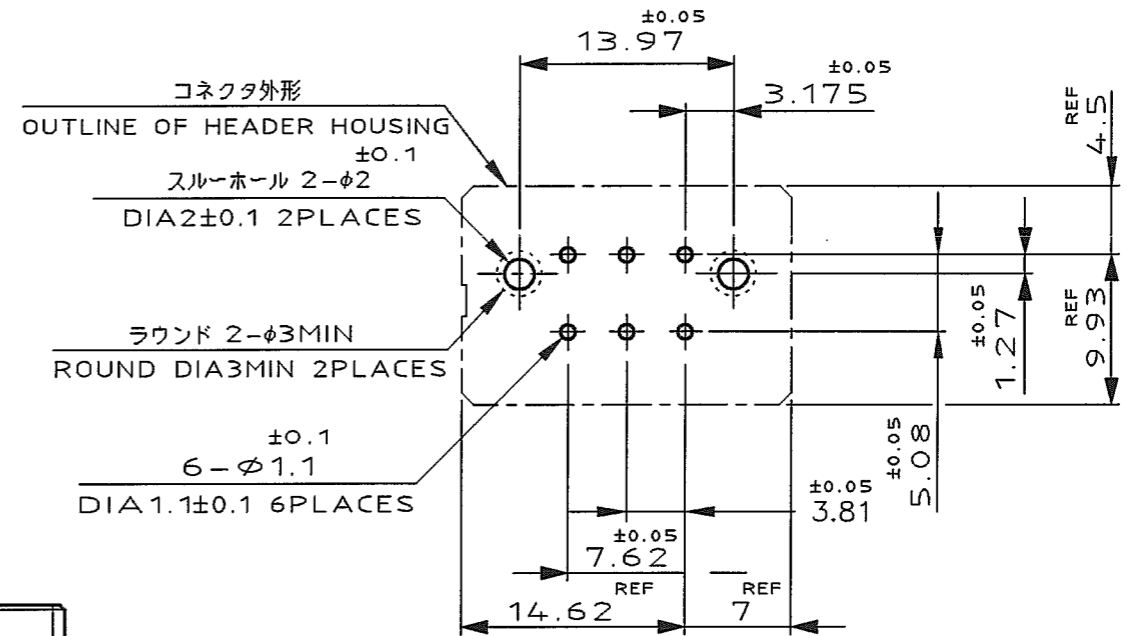
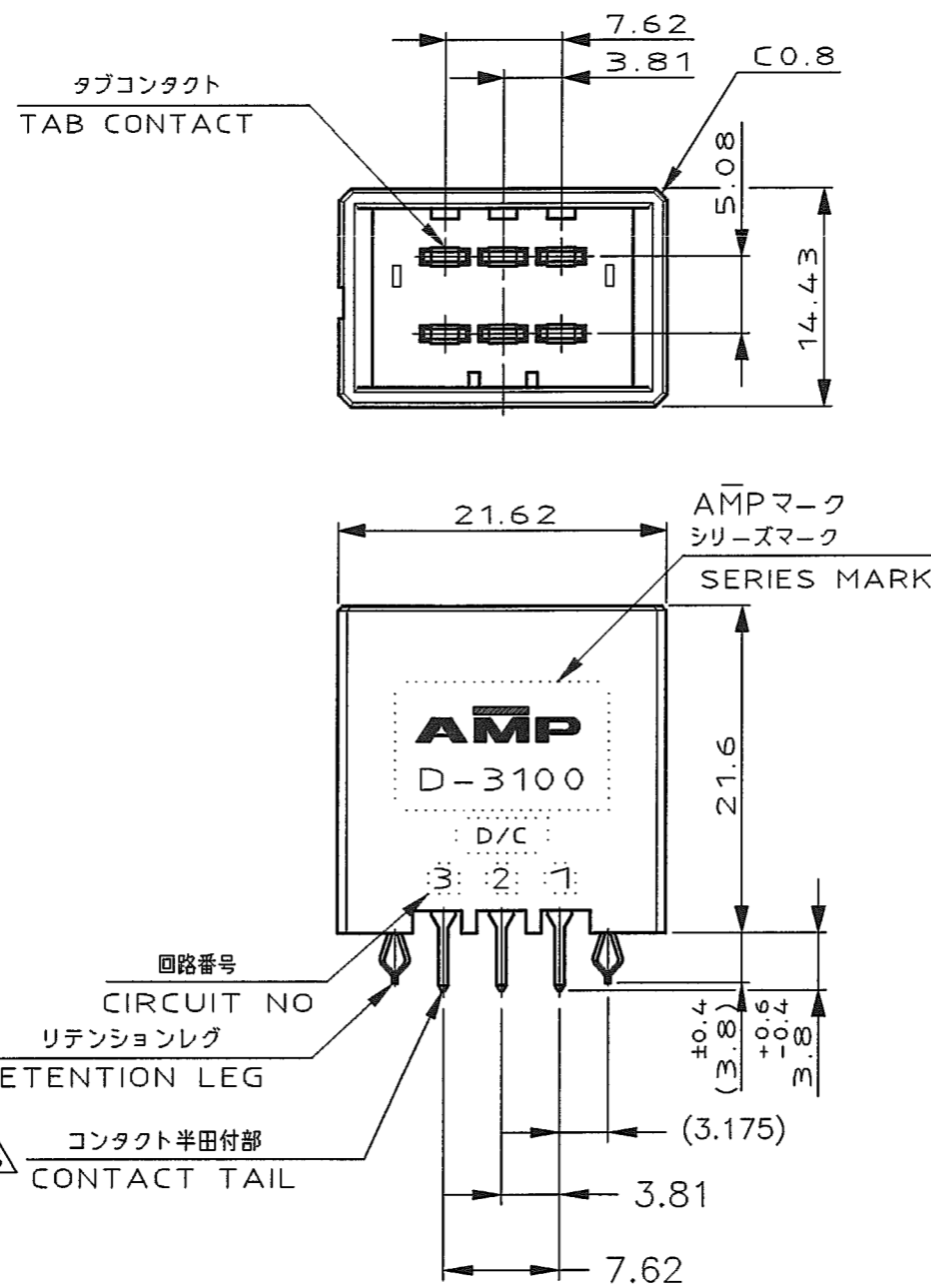
NUMBER 178323



METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



推奨基板取付け穴寸法

PC 基板厚: 1.6±0.1  
(非累積公差)  
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN

PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1  
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)  
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER  
CONTACT: COPPER ALLOY  
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- ~~FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL~~
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂  
コンタクト: 銅合金  
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部: 0.38μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部: 0.76μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- ~~めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
ニッケル下地の上に半田めっき~~
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
ニッケル下地の上にスズめっき

△6	△4	178323-5
△6	△3	178323-3
△6	△2	178323-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

D1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	23MAR11
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME	
mm(AWG - )		mmφ		DOUBLE ROW (D-3100)	
MATERIAL SEE NOTE 注記参照		FINISH SEE NOTE 注記参照		DYNAMIC CONN. 6POS. VERTICAL HDR. ASS'Y	
DR. 15 FEB 91 N. Matsubara		DE. 15 FEB 91 N. Matsubara		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE LOC NUMBER
CHK. 21 MAY '91 T. Obata		APP. 21-MAY-'91 S. MANABE		10mm以下: ±0.3 10mm超 30mm以下: ±0.4 30mm超 100mm以下: ±0.5 角 度: ±3'	A3 J C-178323
				SCALE	REV. SHEET
				2-1	D1 1 OF 1

